长电科技2025年半年度业绩说明会记录

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日（星期四）14:30-16:00通过进门财经电话会议、上证路演中心转播及网络文字互动方式召开了2025年半年度业绩说明会，公司董事/首席执行长（CEO）郑力先生、独立董事董斌先生、董事/首席财务长梁征先生、董事会秘书袁燕女士、副总裁吴宏鲲先生等相关人员就公司2025年上半年经营成果及财务具体情况与投资者进行了交流和沟通，并在有效时间内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

本次会议投资者提出的问题及公司回复情况如下：

1. 公司对AI算力、通信以及汽车电子的市场前景目前是如何判断的?

从封装来看，整个行业处在承前启后，辞旧迎新的阶段。前道和后道更加紧密的联系在一起，围绕算力、通信和汽车电子里的核心的芯片进行协同创新，达成协同发展的状态，从原来的传统技术走向先进技术，从以晶圆为主来驱动半导体业务发展的阶段，到后道封装成为重要的旗手的阶段。在这样的大环境下，市场周期自身的波动性，叠加技术向前发展，会出现革命性的变化。

对长电科技来讲，一方面感受到以上提到的市场快速增长的需求，所以我们在研发资金和资本的投入，都是以更大规模向前推进；同时也对一些业务有所取舍，对于过去曾经的主流产品，面向未来而言，哪怕是大客户的产品，也不要单纯为了追随而参加价格的竞争。

市场在向前发展过程中，我们围绕以上机遇坚决的投入资源。同时对传统的业务有一定的取舍，集中精力把市场未来发展产生的机遇和相关的技术紧紧抓牢。

2. 近期关注到股东华润董事长调研了公司海内外各个工厂，后续跟股东方面会有哪些合作？

华润集团作为长电的大股东，对于长电的发展高度重视。近期集团董事长在长电海内外都做了调研，董事会上通过了对于CEO的授权方案，目的也是为了进一步支持长电保持市场化的机制。因为华润集团长期以来是充分在市场上参与竞争的多元化集团公司，有着非常好的国际视野和战略思维。一直以来从战略、资源协调等方面持续给长电赋能。

在战略层面，华润集团有非常好的战略管理工具，长电也结合我们正在进行的“十五五”规划，运用好华润集团的“四个重塑”等工具，进一步的规划长期发展战略，实现战略对于业务的引领。

在资源协同方面，华润具有多元化的优势，能够为长电提供产业、客户和财务资源等各方面的支持，助力长电在供应链的整合，以及外延式并购，合规体系的建设。现在也正在进行中的，包括对于我们融资以及日常经营等方面都具有非常大的支持。

在人才激励方面，华润集团继续支持长电完善现有人才管理的激励机制，并且将集团的培训能力提升资源提供给长电，强化了长电的梯队和团队的融合能力提升。

在管理工具方面，华润集团过去也有一些经典的5C价值型财务管理体系和6S战略体系的工具和方法，进一步助力长电未来管理体系和能力的升级。

华润集团是一个支持和赋能的角色，长电在积极融入华润的管理体系中，通过这样的双向奔赴，能够提升管理效率，助力业绩的达成，进一步提升长电的企业价值。

3.产能利用率及价格变动趋势？

整体公司的产能利用率在第二季度环比有所提升。

国内工厂订单饱满，其中晶圆级封装、功率器件及电源管理芯片封装产线接近满产；国内存储类需求旺盛，公司正持续扩充紧缺产能以匹配客户需求。海外工厂因部分客户去年第二季度备货量大、基数较高，且今年受外部环境影响第一季度提前备货，海外第二季度产能利用率同环比有所波动；受外部贸易环境变化影响，部分客户做了供应链的调整和排产的重新安排，短期对产能利用率会有影响；公司为适应变化，正加速新订单认证，推动相关工厂生产节奏恢复和正常化。

第三季度逐渐进入客户旺季备货期，虽然季节性相比往年有所平缓，但产能利用率环比继续上升趋势。

今年以来价格承压有所减弱，公司保持随行就市的价格策略。上半年针对国际大宗商品价格上涨，原材料出现价格上涨趋势，公司首先主动消化吸收部分成本、承担涨价的压力，以保持供应链、产业链生态稳定，体现公司在整个产业链的责任担当；同时为保障经营稳健，也逐步启动分批分类价格调整机制，实现大宗商品的联动报价机制，确保将部分成本压力合理传导。

随着需求复苏和产能利用率提升，公司将针对性地做好服务定价及产品结构优化工作，优先聚焦高毛利产品进行产能分配，提升单位产出利润率。

4.先进封装与汽车业务远期目标占比？

汽车行业这两年发生了非常大的变化。市场构成与以往大不相同。过去从车企到一级供应商再到设计公司的传统生产制造链路，如今已出现大幅调整。汽车由于走向智能化，带来了更多的半导体产品和模组进入到汽车。智能终端产品汽车化，不少智能终端厂商也纷纷切入汽车赛道。行业结构的巨大变化，也带动了商业模式与产品形态的调整。因此我们认为，汽车电子市场的发展前景十分广阔。基于这一判断，前几年我们已在汽车领域投入大量资源。我们的业务布局不仅限于传统MCU、传感器等汽车半导体产品的封装，更希望超越封装本身，深度绑定汽车产业各环节，紧跟电子化、智能化的发展方向。大家看到电池大厂，积极的进入到半导体领域，来支持汽车向智能化、新能源化的发展。公司将不断提升汽车收入占比。凭借在该领域的长期积累，我们有信心厚积薄发，开拓出超越传统封装的更大发展空间。

在先进封装领域，定义也在不断的与时俱进。长电科技的晶圆级封装的产能，在2024年下半年已经接近满产，在不断扩充产能，今年上半年晶圆级封装同比增长达到30%，这块业务占比会快速提升。在面向运算类电子相关的收入占比不断提升。

5. 汽车和先进封装未来会有明显增长，公司如何展望下半年和2026年及中期的利润率水平？有什么积极因素会使得整体利润率有比较明显的回升？

下半年从外部环境和应用的领域来看，都是机遇和挑战并存的状况。公司总体上对于下半年达成业绩目标有一定的信心，因为上半年虽有一定利润下滑，但毛利率基本持平。上半年盈利下滑主要有几方面的因素影响：首先是新建工厂和在建项目的投入在加大，形成了阶段性的亏损。第二方面是公司在持续加大研发投入和前沿技术的布局，研发费用会侵蚀一部分利润。第三是财务费用，其中影响比较大的是汇率波动，这是短期的因素。最后是作为龙头公司，在原材料价格上涨的情况下，没有完全向上下游进行转嫁，而是选择主动性消化了一部分的成本，体现了对于产业的责任担当，有利供应链的长期可持续的发展。

展望下半年，一方面国内工厂良好的态势还会持续，另一方面受下半年产品结构变化的影响，公司的毛利率可能会有一定的波动，但是会努力通过加强内部管理，优化管理机制，来降低成本费用的影响。

因为公司在加速向先进封装转型的阶段，所以需要投入大量高端设备，以及升级高性能材料，这会造成我们成本压力的上升，包括折旧和费用的增加。初期这些投入转化为业绩需要一定的时间，部分产品的导入期还没有完全实现量产，盈利的潜力还没有得到充分的释放，所以对我们盈利会带来一定的短期压力。总体上管理层认为目前盈利阶段性的相对低位，是公司转型升级过程中的正常现象，叠加外部经营的不确定性，公司面临一定的挑战。相信未来随着技术的突破，以及先进产品的大量导入，盈利能力会得到逐步释放。

6. 展望下半年需求，公司提到下半年季节性比往年平缓，按照海外与国内的客户，各类不同的应用中，哪些是更好，哪些相对弱一些？

这并非简单的国内外市场强与弱的对比。今年有比较有意思的现象，国内市场的需求确定性更强，回暖的势头稳定。现在国内工厂订单都比较饱满，下半年可以清楚的看到持续增长的势头，叠加了“在中国，为中国”，有不断的新的生产转移到中国市场的趋势。

反而今年海外市场，不一定是强与弱的问题，而是由于国际政策环境的不确定性，海外需求确定性不及国内，呈现此起彼伏的特征。不少客户上月可能因国际贸易因素，看不清生产的预测。下月却会迫切推进封装及供应链比如基板需求的拉升。从海外的客户来讲，先进封装的产品会相对比较多。

当前行业正处于承前启后、新旧交替的关键阶段。从去年开始，我们已针对未来几个季度的产品布局主动做了取舍：若某类需求仅短期有一定规模，但技术含量与未来趋势不符合公司中长期发展方向，即便来自大客户，我们也不会盲目迎合这类短期需求，而是将主要精力聚焦于先进技术与具备长期发展潜力的产品。以面向通信的系统级封装为例，其中既包含面向未来的更高密度、更高技术含量的产品，也存在重复过去传统技术的产品，因此全球头部的几家海外SiP生产企业，也都在主动进行类似的产品取舍。因此，海外需求的变化并非单纯的市场回暖或强与弱的过程，而是在行业新旧产品交替、企业主动转型与取舍的过程中，逐步向前发展的趋势。

7. 可能整体来看今年季节性的节奏并不是上下差异非常大的情况。Q3是常规消费电子旺季。所以如果只看像通讯类的这些大客户，现在看到的订单的情况怎么样？

Q3必然是通信领域大客户的旺季，我们已提前做好充分准备，确保能顺利承接旺季需求。从当前产业链材料供应情况来看，基板等关键材料已出现较为明显的短缺。因此在旺季期间，针对主流通信应用，我们一方面要全力做好产能保障，另一方面，在行业材料紧缺的背景下，与客户协同保障材料供应链稳定，也成为当前的重要课题。整体来看，通信电子旺季的大趋势并未改变。

当前封装产业正从传统封装向先进封装转型，即便在大客户及通信领域，头部企业也在主动进行产品与产能的取舍，将有限的产能和资源，加速向未来新机型、新产品模组转移。因此，未来几个季度，通信领域在传统旺季的基础上，还将叠加行业新旧产品交替、承前启后的转型过程。以上便是我对后续通信类产品及大客户相关业务的判断。

8. 2021年公司提到China for China的趋势，今年初我们明确的看到海外的IDM把面向中国的终端需求向大陆转单，国内工厂比如宿迁和滁州厂目前感受到的情况如何？国内工厂稼动率已经较满的话，后续有无涨价机会？

IDM厂China for China的趋势从去年开始就已较为明显，这一趋势在晶圆厂层面已得到充分体现。随着晶圆产能向国内转移，后道封装环节也需积极承接相应需求。对长电科技而言，这一趋势的影响不仅限于宿迁、滁州工厂，目前这两家工厂已开始导入部分海外新IDM厂的订单，客户结构也因此形成新格局；国内其他工厂，包括江阴的几大主力工厂，同样明显感受到这一趋势带来的变化。

当前，无论是与晶圆厂对接产能需求，还是与客户面向中国市场的设计团队协作、保障新产品在国内的生产落地，相关工作都在紧张有序推进中。我们也已抽调大量人力，为这些工作提供技术与工艺层面的支持和对接，确保各项需求高效落地。

关于此前提到的涨价问题，近两年集成电路产业呈现此起彼伏的逐步增长态势。受金价及部分核心材料价格明显上涨的影响，我们正与客户积极沟通协商。不过，目前并未因产能紧张而短期向客户主动推动价格调整，这方面暂未成为我们的核心工作。在产业链各环节，我们更倾向于与全产业链伙伴协同，共同伴随半导体产业复苏，主动承担起产业链责任，这是我们的核心方向。

9. 预计在今明两年会有越来越多的超薄Air机型或折叠机型以及智能眼镜等可穿戴产品对外发布，更轻薄的外观对内部SiP模组的规格是否提出新的要求？规格升级能带来多大的价值量和份额提升的空间？

目前智能终端行业确实正经历显著的技术变革，这一点在各类报道中也能看到，且并非某一家大客户的单独需求，而是几家主流客户的共同趋势。这一趋势下，市场对SiP产品的要求明显提升，尤其是密度方面的突破尤为突出。在SiP领域，2.5D、3D立体架构成为重要方向，需要将更多高端芯片、被动器件集成到更小体积、更高密度的封装中，同时还要满足更优的热效能、供电效能与信号处理能力。

具体到手机主芯片，其封装需求已呈现类似数据中心的技术方向，把晶圆级的封装，垂直供电的概念，甚至和存储之间的高密度的互联，都要集中在一起的要求。某种意义上来讲，面向手机的技术含量，比数据中心所要求的难度更高。受限于手机更轻薄、面积更小的特性，对设计的精细度、集成度提出了更严苛的标准。也正因如此，我们看到越来越多兼具创新性与技术含量的新产品涌现，而目前我们已成功拿下部分前期产品的客户design-win，这一成果令人鼓舞。

结合此前提到的产品取舍策略，对于部分相对传统的SiP产品，即便仍有一定市场规模，也并非我们近期重点争取的方向。我们更倾向于将有限的资本开支与投资资源，集中投向这类新一代高密度SiP产品，这正是我们未来核心的发力方向。

10. 公司在先进封装上的规划和产能建设，今年的capex是否会因应调整？

先进封装技术正处于动态演进中，一些此前的主流概念，比如一两年前2.5D/3D被视为封装核心的技术，到今年、明年又将发生显著变化。也正因如此，我们必须加大先进封装领域的投资，全面覆盖当前各类前沿技术。事实上，长电科技无论在海外研发中心还是国内团队，都已在这些技术方向上布局多年；当前阶段，我们正进一步加大投入，推动这些技术从研发走向客户产品导入环节，而前期的产能布局也已纳入研发与资本投入规划，各项工作均在积极推进。

资本支出方面，公司目前仍维持全年85亿元的开支计划不变。资金投向主要聚焦几个方向，从研发布局上，我们会继续聚焦在先进封装的项目以及它的技术突破上面；在应用层面，重点投向汽车电子、功率与能源等市场增长迅速的领域。从当前先进封装需求持续旺盛的趋势来看，我们预计明年也将保持一定的投资强度，但具体规划将按公司时间表，通常在年初进行披露。

11. 韩国业务利润为负，是什么原因造成？谢谢

报告期内，长电韩国受国际环境影响，订单量呈现小幅波动；同时，产品结构调整，新品材料成本占比较大，使得净利润较大幅度下降。另外叠加美元汇率上半年贬值走势，对业绩也造成影响。

12. 请问新任董事长什么时候能到位？

公司正在按照规定履行相应法定程序，尽快完成公司董事长的选举工作。

13.我们长电是否有对标台积电CoWoS的技术？我们的3D封装技术有没有为国际HBM的大厂服务？最后一个问题郑总，对长电的技术发展的宏观愿景是什么，有没有与宏大愿景相适应的人才战略和计划？

长电科技依托深厚的技术积累与丰富的量产经验，与国际领先企业保持技术同步发展，在存储相关封测技术处于行业领先的地位。未来，公司将持续不断优化技术布局与工艺能力，为全球客户提供更优质的封装测试服务。

公司的愿景是成为全球一流的集成电路制造和技术服务提供商，回馈股东、客户、员工和社会。公司将进一步深化发展战略，实现战略引领下的发展；充分发挥长电科技先进制造和技术资源优势，继续优化全球业务布局，持续加大研发创新投入，为客户提供全面、完善的一站式解决方案，实现应用驱动创新，保持技术和市场份额的全球领先地位。

人才建设方面，公司持续围绕“建设人才梯队、夯实人才密度、打造高韧性敏捷组织与文化”的工作重点，深化人才体系建设，精准匹配人才与业务需求，强化人才稳定性，建立了高效的人才梯队。公司通过全球招聘技术人才、引进行业专家、实施“芯火计划”及卓越工程师计划等举措，在人才吸引、培养与保留等方面取得了显著成效。

14. 你好，看之前的公告，公司大股东的资产会注入上市公司，目前进展如何？

公司未披露您提及的相关事项。如有需披露的信息，公司将按照监管要求及时履行信息披露义务，并通过官方渠道向投资者公开。建议您关注公司指定信息披露平台。感谢您的提问！

15. 公司的境外收入占比高（约80.91%），公司如何面对全球贸易环境的潜在不确定性。还有北美大客户新品发布情况如何。

公司将继续坚持国际化、专业化的经营，实现高质量发展的经营方向，通过灵活调整策略来应对潜在的市场风险，持续聚焦高附加值和快速增长的市场热点应用，不断优化产品结构和业务比重，提升自身生产和管理能力，通过布局新的产品和技术，不断提升竞争力，并积极把握功率，汽车电子，高性能计算和存储市场发展机遇，通过战略并购与投资，推动新客户的拓展和与现有客户加深合作来扩大市场覆盖。

16. 消费电子需求疲软，长电宿迁和滁州工厂亏损扩大，公司后期会有调整么？

公司将积极调整产品结构并推动工艺技术转型迭代以适应市场变化，更大力度推动工厂从传统封装向先进化转型；针对原材料成本上涨，公司已逐步启动价格调整机制，实施大宗商品的联动报价机制，努力推动国内工厂盈利回升。

17. 如何看待今日对公司股价的表现，市值管理是否已纳入长远规划，下半年支出和收入平衡情况怎么样？

股价波动受宏观经济、行业环境及市场等多重因素影响。公司高度重视市值管理工作并已建立《市值管理制度》，未来公司将继续坚持聚焦主业、稳健经营，通过优化治理结构、加强投资者关系管理、提升信息披露质量等措施，持续向市场传递公司价值。关于公司下半年的收入与支出情况，请以公司定期报告披露的信息为准。感谢您的提问。